Datenblatt
Desing-Rules - Herstellung Leiterplatten DKL

Abstände und Mindeststärken EEL, DKL, MLL

	Standard	nach Prüfung
Leiterzug - Leiterzug	≥ 0,15 mm	≥ 0,125 mm
Leiterzug - Lötauge	≥ 0,15 mm	≥ 0,125 mm
Lötauge - Lötauge	≥ 0,15 mm	≥ 0,125 mm
Leiterzugbreite	≥ 0,15 mm	≥ 0,125 mm
Restring Via's	≥ 0,15 mm	≥ 0,125 mm
Restring THT-Bauteile	≥ 0,22 mm	≥ 0,2 mm
Strichstärke Bestückungsdruck	≥ 0,15 mm	

Gilt für 35µm Endkupferstärke. Bei größeren Kupferstärken erhöhen sich diese Werte!

Bohrungen und Fräsungen

kleinste Bohrung	0,3 mm	nach Prüfung 0,2 mm
größte Bohrung	6,1 mm (darüber gefräst)	
kleinster Fräser	0,5 mm	
größter Fräser	3,0 mm	

Standardfräser ist 2,0 mm bzw. 2,4 mm

Nutzbare Fläche

Nutzen 266 x 388	240 x 360 mm
Nutzen 356 x 388	330 x 360 mm
Nutzen 356 x 532	330 x 504 mm
Nutzen MLL 300 x 400	237 x 320 mm
Nutzen MLL 340 x 500	316 x 450 mm